

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2025-026

锦州神工半导体股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年10月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票10,305,736股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.11元，募集资金总额为人民币299,999,974.96元，扣除不含税的发行费用人民币3,943,396.22元后，实际募集资金净额为人民币296,056,578.74元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年9月15日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]110Z0012号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上情况详见2023年10月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金累计已投入金额	募集资金累计已投入比例
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	21,000.00	20,905.66	7,712.05	36.89%
2	补充流动资金	9,000.00	8,700.00	8,748.11	100.55%
合计		30,000.00	29,605.66	16,460.16	55.60%

注：公司募投项目及募集资金使用和存放具体情况详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司 2025 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	2025 年 10 月	2026 年 10 月

（二）本次募投项目延期原因

公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍存在较多不可控因素，主要受外部宏观市场环境、经济环境、下游需求等诸多客观性因素影响。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步逐步投入该项目。在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施方式的前提下，公司拟将上述募投项目预定可使用状态日期调整至 2026 年 10 月。本次募投项目延期不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长远发展规划。

（三）保障延期后按期完成的相关措施

公司将密切关注行业发展方向及市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划产能，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。

四、本次部分募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 10 月。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，该事项无须提交股东大会审议，公司已履行了必要的审批程序。该事项不存在改变募投项目的实施主体、实施方式、投资规模、募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日